PAT-NO:

JP406044743A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06044743 A

TITLE:

PLURAL DISK DRIVES ASSEMBLIES

PUBN-DATE:

February 18, 1994

INVENTOR-INFORMATION: NAME MICHAEL, ROBERT HATCHETT HEATH, JOHN S LEE, HUBERT C ROW, EUN K SPENCER, ROGER D WORKMAN, MICHAEL L

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

INTERNATL BUSINESS MACH CORP <IBM>

N/A

APPL-NO:

JP05043585

APPL-DATE:

March 4, 1993

INT-CL (IPC): G11B025/04, G11B033/12

## ABSTRACT:

PURPOSE: To provide the plural disk drive assemblies of a form factor, which can be connected through standard connectors and which have the head/disk assembly(HDA) of the form factor of a disk drive installed on a base.

CONSTITUTION: An interface connector 55, a power supply connector 53 and the pattern of an opening, which fixes a frame, have standard dimensions having compatibility with the disk drive of 3.5 inches in the form factor of 5.25 inches given by a manufacturer so that they can be used in the computer system of a different type. A single controller substrate 15 shared by both HDA is installed under the base 16. A spring-type vibration attenuation device 47 is used for reducing the influence of vibration which is internally generated by adjacent HDA to be a minimum.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-44743

(43)公開日 平成6年(1994)2月18日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示簡所

G11B 25/04

101 A

33/12

313 C

審査請求 有 請求項の数22(全 13 頁)

(21)出願番号

特願平5-43585

(22)出願日

平成5年(1993)3月4日

(31)優先権主張番号 850321

(32)優先日

1992年3月10日

(33)優先権主張国

**米国(US)** 

(71)出願人 390009531

インターナショナル・ビジネス・マシーン

ズ・コーポレイション

INTERNATIONAL BUSIN

ESS MASCHINES CORPO

RATION

アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州

アーモンク (番地なし)

(72)発明者 マイケル・ロバート・ハチェット

アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンノ

ゼ、デザート・フレーム・ドライブ 6322

(74)代理人 弁理士 頓宮 孝一 (外4名)

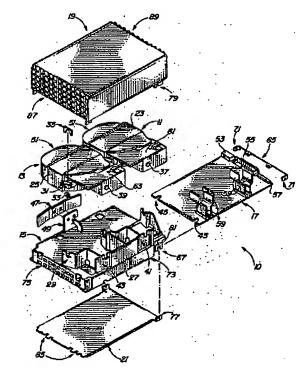
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 デイスク・ドライブ・システム

### (57)【要約】

【目的】 標準のコネクタを介して接続可能であり、か つ、基台上に装着された3.5インチのデイスク・ドラ イブのフオーム・フアクタのヘッド及びデイスク組立体 (HDA)を有する5.25インチのHDAのフオーム ・フアクタの複数デイスク・ドライブ組立体を与えるこ と。

【構成】 インターフエイス用コネクタ及び電力供給用 コネクタと、フレームを固定する開孔のパターンとが、 異種のコンピユータ・システムにおいて使用できるよう に、製造業者によつて与えられた5.25インチのフオ ーム・フアクタのデイスク・ドライブと互換性を有する 標準寸法を持つている。両方のHDAにより共用される 単一のコントローラ基板が基台の下部に装着されてい る。隣接したHDAによつて内部的に発生される振動の 影響を最小限にするために、スプリング式の振動減衰装 置が使用される。



12/21/04, EAST Version: 2.0.1.4

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 5.25インチの形状特徴値のデイスク・ドライブの長さにほぼ等しい長さと、5.25インチの形状特徴値のデイスク・ドライブの幅にほぼ等しい幅を有する基台と、

2つのデイスク・ドライブの各々が5.25インチの形状特徴値のデイスク・ドライブの幅にほぼ等しい長さと、5.25インチの形状特徴値のデイスク・ドライブの長さの半分にほぼ等しい幅を有し、上記基台上に装着された情報ストア用の2つのデイスク・ドライブと、制御信号を与えるために、上記2つのデイスク・ドライブに接続された制御手段と、

上記制御信号に応答して、上記2つのデイスク・ドライブからの情報、または上記2つのデイスク・ドライブへの情報を結合するデータ手段とからなる5.25インチの形状特徴値のデイスク・ドライブ・システム。

【請求項2】 上記基台と同じ寸法を有し、上記基台に 係合され、上記基台に装着された上記2つのデイスク・ ドライブを収納するカバーは、上記基台と上記カバーと の間に制御された環境を与えることを特徴とする請求項 20 1に記載のデイスク・ドライブ・システム。

【請求項3】 上記2つのデイスク・ドライブの下側で、上記基台の下部側に装着されたコントローラ基板を含み、上記制御手段及び上記データ手段は上記コントローラ基板上に設けられていることを特徴とする請求項1に記載のデイスク・ドライブ・システム。

【請求項4】 上記基台とほぼ同じ寸法を有し、上記基台上に装着された上記2つのデイスク・ドライブを収容し、かつ、上記基台と係合する上部カバーを含み、該上部カバーは上記基台と上記上部カバーとの間で制御され 30 た環境を与えることを特徴とする請求項3に記載のデイスク・ドライブ・システム。

【請求項5】 基台とほぼ同じ寸法を有する上部カバーと下部カバーとを含み、上記上部カバーは基台上に装着された2つのデイスク・ドライブを収納し、かつ、上記基台と係合し、上記基台は基台の対向する2つの側から下方向に延びた少なくとも2つの対向する側壁を有し、上記下部カバーは上記コントローラ基板を収納するために、上記対向する側壁と係合することを特徴とする請求項3に記載のデイスク・ドライブ・システム。

【請求項6】 上記上部カバーの対向する前方側及び後方側は、上記上部カバーによつて収納された素子を冷却するために、冷却媒体用の入口及び出口を与える少なくとも1つの開孔が形成されていることを特徴とする請求項5に記載のデイスク・ドライブ・システム。

【請求項7】 上記基台は、冷却用の開孔のパターンを有する下方に延びた壁部を含み、上記下側に延びた側壁及び前壁を上記下部カバーと係合することによって形成された収納室は、上記コントローラ基板へのアクセスと、冷却媒体の流路とを与える後壁の開口を持つことを

特徴とする請求項6に記載のデイスク・ドライブ・システム。

【請求項8】 上記コントローラ基板は上記2つのディスク・ドライブの各々のための別個のアドレスをセツトするためのアドレス手段を含み、上記デイスク・ドライブの各々は独立してアドレス可能であることを特徴とする請求項3に記載のデイスク・ドライブ・システム。

【請求項9】 上記コントローラ基板は上記2つのデイスク・ドライブの両方に対して共通の少なくとも1つの10 コネクタを含み、該コネクタは上記コントローラ基板をホスト・コンピユータ・システムと結合するためのケーブル接続を与えることを特徴とする請求項3に記載のディスク・ドライブ・システム。

【請求項10】 上記コントローラ基板は、該コントローラ基板をホスト・コンピユータ・システムの電源に接続するための電源用の共通コネクタと、上記コントローラ基板をホスト・コントローラに接続するための共通のインターフエイス・コネクタとを含むことを特徴とする請求項9に記載のデイスク・ドライブ・システム。

20 【請求項11】 選択された形状特徴値のデイスク・ドライブの長さとほぼ同じ長さと、上記選択された形状特 徴値のデイスク・ドライブの幅とほぼ同じ幅とを有する 基台と

情報をストアするためのN個のデイスク・ドライブを含み、上記N個のデイスク・ドライブの各々は、上記選択された形状特徴値の長さの第1の倍数にほぼ等しい長さと、上記選択された形状特徴値の幅の第2の倍数にほぼ等しい幅とを有し、上記第1及び第2の倍数はNとは異なつた関数であり、N個のデイスク・ドライブは上記基台の上側に装着されていることと、

制御信号を与えるために上記N個のデイスク・ドライブ に接続された制御手段と、

上記制御信号に応答して、上記N個のデイスク・ドライブからの情報及び上記N個のデイスク・ドライブへの情報を結合するためのデータ手段とを含む標準形状特徴値の複数デイスク・ドライブ・システム。

【請求項12】 上記基台とほぼ同じ寸法を有し、上記基台上に装着された上記N個のデイスク・ドライブを収納し、かつ、上記基台に係合するカバーを含み、該カバーは上記基台及び上記カバーとの間に、制御された環境を与えることを特徴とする請求項11に記載の標準形状特徴値の複数デイスク・ドライブ・システム。

【請求項13】 上記N個のデイスク・ドライブの動作中における振動及び衝撃の影響を最小限にするために、上記N個のデイスク・ドライブの各々に対して力を結合するための上記基台に装着された振動減衰手段を含むことを特徴とする請求項11に記載の標準形状特徴値の複数デイスク・ドライブ・システム。

された収納室は、上記コントローラ基板へのアクセス 【請求項14】 上記データ手段が装着され、かつ、上と、冷却媒体の流路とを与える後壁の開口を持つことを 50 記N個のデイスク・ドライブの下側で、上記基台の底部 12/21/04, EAST Version: 2.0.1.4

側に装着されたコントローラ基板を含むことを特徴とする請求項11に記載の標準形状特徴値の複数デイスク・ドライブ・システム。

【請求項15】 上記コントローラ基板は少なくとも1 つのコネクタを含み、該コネクタは上記N個のデイスク・ドライブに共通のコネクタであり、かつ、上記コントローラ基板をホスト・コンピュータ・システムに接続するケーブル接続を与えることを特徴とする請求項14に記載の標準形状特徴値の複数デイスク・ドライブ・システム。

【請求項16】 上記コントローラ基板は該コントローラ基板をホスト・コンピユータ・システムの電源に接続するための電源用の共通コネクタと、上記コントローラ基板をホスト・コンピユータ・システムのコントローラに接続する共通のインターフエイス・コネクタとを含むことを特徴とする請求項15に記載の標準形状特徴値の複数デイスク・ドライブ・システム。

【請求項17】 基台と、

上記基台の上側に装着され、情報をストアするN個のディスク・ドライブと、

上記N個のデイスク・ドライブの動作中に生じる衝撃及び振動の影響を最小限に止めるために、上記デイスク・ドライバの各々に対する力を結合する上記基台に装着された振動減衰手段と、

制御信号を与えるために上記N個のデイスク・ドライブ に接続された制御手段と、

上記制御信号に応答して、上記N個のデイスク・ドライブからの情報及び上記N個のデイスク・ドライブへの情報を結合するためのデータ手段とを含む複数デイスク・ドライブ・システム。

【請求項18】 上記データ手段を装着し、かつ、上記 N個のデイスク・ドライブの下側で、上記基台の底部側 に装着された共通のコントローラ基板を含むことを特徴 とする請求項17に記載の複数デイスク・ドライブ・システム。

【請求項19】 上記振動減衰手段は上記N個のデイスク・ドライブの各々に対して摩擦力を加えるためのスプリング手段を含むことを特徴とする請求項18に記載の複数デイスク・ドライブ・システム。

【請求項20】 N個のデイスク・ドライブは2つのデ 40 イスク・ドライブであり、上記デイスク・ドライブの各 々は上記基台に装着するための独立したハウジング中に 収容されていることを特徴とする請求項17に記載の複数デイスク・ドライブ・システム。

【請求項21】 上記振動減衰手段は上記デイスク・ドライブの独立したハウジング上の選択された接触点において、上記2つのデイスク・ドライブの各々に摩擦力を加えるためのスプリング手段を含むことを特徴とする請求項20に記載の複数デイスク・ドライブ・システム。

おいて上記スプリング手段と上記デイスク・ドライブの各々との間に選択された摩擦係数を与えるために、上記2つのデイスク・ドライブから、上記スプリング手段を電気的に絶縁するための耐摩耗性の絶縁材料の層で被覆されていることを特徴とする請求項21に記載の複数デイスク・ドライブ・システム。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、複数個のデイジタル・10 データ・ストレージ装置のシステム、より具体的に言えば、特定の物理的寸法を有する少なくとも2つの高容量デイスク・ドライブにより構成され、標準化されたより大きな形状特徴値を持つように組立てられて、単一の装置を形成したデータ・ストレージ装置に関する。

[0002]

20

【従来の技術】コンピユータ・システムの1つの主要な要素は、データをストアするための装置である。代表的なコンピユータ・システムは、コンピユータ・システムによつて使用するためのデータをストアする幾つかのストレージ手段を用いている。コンピユータ・システムは、例えば、デイスク・ドライブ、即ち、直接アクセス・ストレージ装置(DASD)と呼ばれる周辺ストレージ装置中にデータをストアすることができる。

【0003】デイスク・ドライブ、即ちDASDは、通常のレコード・プレイヤで用いられているレコード、または、CDプレイヤで用いられているコンパクト・デイスク(CD)と同じような外形の1枚、または、それ以上のデイスクを含んでいる。レコードのようなデイスクは、平行な平面内で回転運動を行なう軸に対して積み重ねられている。然しながら、デイスク・ドライブにおいては、デイスクは、相互に離隔して回転軸に装着されているので、離隔したデイスクは相互に接触しない。

【0004】回転する磁気デイスク、あるいは、回転す る光学媒体デイスクを用いるデータ・ストレージ装置 は、高い記憶密度を持ち、しかも低価格の装置として広 く知られている。このようなデイスクは、通常、片方の 面上か、または両方の面上に複数個の同心円のデータ・ トラツクを持つており、夫々のデータ・トラツクは、情 報をストアすることができる。各データ・トラツクにス トアされた情報は、トラツク探索動作の間でトラツク間 を移動される変換ヘツドによつてアクセスされ、変換へ ツドは、デイスク装置の読取り専用トラツクの追従動作 か、または、読取り/書込みトラツクの追従動作の間で トラツクと整列して保持される。通常、各データ・スト レージ面に対して、1つ、または、それ以上の変換ヘツ ドが与えられている。ヘツドに対してデイスクを回転さ せ、そして、トラツクにアクセスするために、デイスク 面の半径方向に相対的にヘツドを移動させるための電気 機械的な組立体は、ヘッド及びデイスクの組立体 (HD

【請求項22】 上記スプリング手段は、上記接触点に 50 A)と呼ばれている。各データ・トラツクの範囲内にへ 12/21/04, EAST Version: 2.0.1.4

ツドを維持するために、制御機構が与えられており、この制御機構は、閉ループ・サーボか、または時間サンプル・サーボで動作するステツプ・モータか、または、連続位置付けアクチユエータによつて与えられるデテント(移動止め)の形式を取ることができる。加えて、HDAをコントローラに接続し、かつ、デイスク・ドライブとコンピユータ・システムとの間のコミユニケーションを行なうために、インターフエイス装置が必要とされる。通常、例えば、小型コンピユータの同期インターフエイス(Small Computer Synchronous Interface-SCSI)のような標準化されたインターフエイスが用いられている。

【0005】データ・ストレージに関する現在の技術は、標準化の方向と、ストレージ容量を増加し、ストレージ装置の重量及びサイズを小さくし、そして消費電力を減少させる方向に向けて絶えず進んでいる。フオーム(form)フアクタと呼ばれている寸法及びインターフェイスの互換性の標準化は、パーソナル・コンピュータ(PC)及びワークステーションのシステムと、大型コンピュータのシステムとの両方の製造業者によつて求め20られてきた。従つて、幾つかの異なつた製造業者により製造された標準の形状特徴値(form factor)及びプラグ・イン構成で与えられた異なつた性能及び容量を有するデイスク・ドライブは、パーソナル・コンピュータの他の製造業者によつて与えられた標準化された装着用スロツトを介して、異なつたパーソナル・コンピュータでも、相互に使用することができる。

【0006】デイスク・ドライブの寸法を小さくする と、同時に、システムのストレージ容量を増加すること は、ストレージ媒体領域の減少、つまり、デイスク面上 のストレージ領域の減少と、これに対応するストレージ 容量の減少との間のバランスを注意深く考慮することが 必要である。通常は、回転軸1本当りのデイスクの枚数 を増加するか、または、デイスク・ドライブの数を増加 することにより妥協が計られる。大型のコンピユータ・ システムにおいては、必要な電力を全体として減少させ るために、例えば、共通の電源と共通の冷房設備とを用 いる利益を利用すると同時に、高いストレージ容量を得 るために、多数の比較的小さなデイスク・ドライブが引 出しの中に装着されている。然しながら、例えばPCに 40 おいては、ユーザは、PCの製造業者によって与えられ た標準的な形状特徴値を持つ装着用スロット中に個々の デイスク・ドライブを付加することに制約され、相対的 に高価な独立型のデイスク・ドライブを付加することに なる。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】従つて、本発明の目的は、少なくとも2つのHDAを含み、コンピユータ業界で標準の形状特徴値を持つデイスク・ドライブの組立体を提供することにある。

【0008】本発明の他の目的は、共通のフレーム上に装着された2つの3.5インチ(88.9ミリメートル)のHDAの形状特徴値を含み、5.25インチ(133.35ミリメートル)のHDAの形状特徴値を持つデイスク・ドライブを提供することにある。

【0009】本発明の他の目的は、少なくとも2つのHDAと、一枚のコントローラ基板とを含むデイスク・ドライブの組立体を提供することにある。

【0010】本発明の他の目的は、共通のインターフエ 10 イス用コネクタを通して別個にアドレス可能な少なくと も2つのHDAを含むデイスク・ドライブの組立体を提 供することにある。

【0011】本発明の他の目的は、コンピュータ業界で 標準とされているデイスク・ドライブの形状特徴値に従 つて組立てられている少なくとも2つのHDAを含む1 つのデイスク・ドライブ組立体を提供することにあり、 このデイスク・ドライブ組立体は、コンピュータ・シス テムの製造業者によつて与えられた形状特徴値と同じ形 状特徴値の装着用スロット及びラックを持つコンピュー タ・システムの形状特徴値のデイスク・ドライブと相互 に交換可能である。

### [0012]

【課題を解決するための手段】本発明の上述の目的及び 他の目的は、装着フレーム、即ち基台と、少なくとも2 つのHDAとを含む複数デイスク・ドライブ組立体によ つて達成され、上述の基台は、選択されたデイスク・ド ライブの形状特徴値の長さにほぼ等しい長さと、選択さ れたデイスク・ドライブの形状特徴値の幅とほぼ等しい 幅を持つており、そして、基台の上側には2つのHDA が装着され、各HDAは、選択されたデイスク・ドライ ブの形状特徴値の幅にほぼ等しい長さと、選択されたデ イスク・ドライブの形状特徴値の長さの約半分に等しい 幅とを持つている。更に、複数デイスク・ドライブ組立 体は、2つのHDAの下側にあり、かつ、基台の下部に 装着された1枚の共通のコントローラ基板を含んでお り、このコントローラ基板上の後縁側に共通の電力供給 用コネクタと、インターフエイス用コネクタとが設けら れている。また、コントローラ基板の後縁側に装着され た共用ジャンパ、即ち、選択用ブロックによつて、夫々 のHDAに対して、独立したアドレスの設定が行なわれ る。基台の上部及び下部に装着される上部カバー及び下 部カバーは、HDAを収納する上部収納室と、コントロ ーラ基板を収納する下部収納室とを形成し、そして、選 択されたデイスク・ドライブの形状特徴値とほぼ同じ外 径寸法を持つデイスク・ドライブ組立体を与える。

【0013】本発明の複数デイスク・ドライブ組立体は、剛直なフレーム上に装着され、コンピユータ業界で共通した標準インターフエースによる3.5インチの2つのデイスク・ドライブの形状特徴値を有する5.25 インチのデイスク・ドライブの形状特徴値のディスク・

ドライブ組立体を与える。インターフエイス用コネクタ 及び電力供給用コネクタと、フレーム取り付け用開孔の パターンとは、デスクトツプのパーソナル・コンピュー タのようなコンピユータ・システムに使用するため、製 造業者によつて与えられた5.25インチの形状特徴値 のデイスク・ドライブとの間で互換性を与えるような業 界の標準に準拠するものである。2つのHDAに対する すべての制御機能及び電力供給と、各HDAへのデータ 転送、または各HDAからのデータ転送とを与えるため の1枚の電子コントローラ基板は、2つのHDAによつ 10 て共用される。コントローラ基板は、シングル・エンデ ツドSCSIか、またはIPIインターフエイスの何れ かか、或は、他のバージョンで実施される。上部及び下 部カバーは、ホスト・コンピユータ・システムによって 与えられる空調を利用して電子素子を充分に冷却するた めに、HDA及びコントローラ基板の周囲に充分な空間 を与える上部及び下部収納室を有するデイスク組立体を 与える。HDAに影響を与える外部及び内部の振動及び 衝撃を最小にするスプリング式の振動減衰装置が用いら れる。デイスク・ドライブ組立体は、EMC及びRFI 保護を与えるために金属カバーで完全に包囲されてい

【0014】本発明は、共通の電子回路と、共通に操作 可能なインターフエイス用コネクタとを有する5.25 インチの標準の形状特徴値の制限の中で1つの組立体中 に2つのデイスク・ドライブのアレイを与える。このア レイの性能は、ユーザのコンピユータのオペレーティン グ・システム・ソフトウエアを書き替えたり、または修 正したり、或は、特別なコントローラとか、インターフ エイスとかを準備することなく種々の構成に対して最適 30 化することができる。例えば、2ドライブの組立体は、 一方のデイスク・ドライブは「緊急用」の予備的なデイ スク・ドライブとして維持され、他方のデイスク・ドラ イブは、データ・ストレージとして使用される2つの独 立したデータ・ストレージ・フアイルとして使用するこ とができ、別個にアドレス可能な2つのデイスク・ドラ イブを与える。他の実施例として、2つのデイスク・ド ライブのアレイを「単一の」デイスク・ドライブを与え るように構成して、記憶媒体の容量を2倍にするとか、 或は、2つのデイスク・ドライブの内の一方のデイスク ・ドライブを記憶データのコピー用(ミラー化されたデ ータ)として使用することができる。

【0015】本発明の2ドライブ組立体は、同じ寸法を持つ5.25インチのデイスク・ドライブよりも大きなストレージ容量を与え、しかも、消費電力は少なくてすむ。加えて、3.5インチのデイスク・ドライブの回転期モータは、5.25インチのデイスク・ドライブの回転軸用モータよりも遥かに小型なので、始動を直列化することができ、始動電流を小さくすることができる。【0016】

【実施例】図1及び図2を参照すると、本発明の原理を 適用した複数デイスク・ドライブ・システムの実施例の 斜視図が示されている。複数デイスク・ドライブ・シス テム10は、2つのヘッド及びデイスクの組立体 (Head and Disk Assembly-HDA) 11及び13と、コント ローラ基板17とのための収納室を与えるために、フレ ーム、即ち基台15の上側及び下側に装着された上部カ バー19と下部カバー21とを含み、基台15の上側に 装着された2つのヘツド及びデイスクの組立体11及び 13と、基台15の下側に装着された共通コントローラ 基板17とで構成されている。各HDA11及び13 は、夫々、独立したHDAのハウジング23及び25の 中に収容されており、各ハウジングは、図5及び図6を 参照して以下に細述されるように、回転軸及びそれに固 着されたデイスクと、回転軸用モータと、アクチユエー タ及び読取り/書込み変換器アセンブリとを装着した強 固なフレームを与えている。基台15は、基台上にHD A11及び13を装着するための装着ブラケット27を 含んでいる。HDA11及び13は、例えば、スタツド 31、係合溝29及び固定用クリップ35によつて、基 台15上に併置して固定されている。基台15から機械 的な隔離を与えるために、ゴム製のショック・アブソー バ33のような緩衝装置がHDA11及び13の装着位 置に与えられている。同様に、スタツド37及び39

【0017】また、基台15は振動減衰装置47を装着するための装着ブラケット49を含んでいる。振動減衰装置47は、HDA11及び13が基台15上に装着された時、各HDAハウジング23、25の前面側51に力が印加されるような態様でブラケット49に装着されている。振動減衰装置47は、HDAのハウジング上に働く制御力を与えるステンレス鋼のスプリングを含んでいる。ステンレス鋼のスプリングは、HDAハウジング23、25と振動減衰装置47との間で電気絶縁体と確実な摩擦係数とを与えるために、XYLAN1010のような耐摩耗性の絶縁体で被覆されている。振動減衰装置47は、ボルト及びナット、または他の適当な手段で装着ブラケット49に強固に固定されている。

が、固定用板41及び43のスロットに係合し、更に、

他のスタツド及びクリツプの組み合せ(図示せず)、ま

たは他の適当な固定手段がHDA11及び13をブラケ

ツト27に固定する。

【0018】例えば、基台15のような共通のフレームに2つ、またはそれ以上のHDAを装着する時に、フレームは、外部からの振動及び衝撃と、HDA自身により発生される振動との両方による影響を最小限にとどめるよう充分に強固でなければならない。例えば、回転磁気デイスクによつて発生された回転トルクは、低周波数の振動を発生するHDAハウジングに転送される。この振動は、また、装着フレームを介して隣のHDAに転送されることがあり得る。このような振動による1つの結果

としては、トラツクの整列ミスを生じることがあるの で、ヘツド・トラツキングのサーボ・システムに対して 負担を増加させる。例えば振動減衰装置47のような緩 衝システムの使用は、装着フレームの剛性及び脆性の要 件を軽減するので、装着フレームの設計の際に材料の選 択について広い範囲を与え、装着フレームは、より質量 の小さいフレームにすることができる。良好な実施例に おいて、振動減衰装置47は、各HDA11及び13の 前面側51に対して0.8キログラム乃至2.0キログ ラムの範囲内の摩擦緩衝力を与える。振動減衰装置47 によつて加えられた摩擦力は、個々のHDAの低周波共 振を最小にし、そして、隣接するHDAの間の振動及び 衝撃の伝送を最小限にするために、例えば、HDAの振 動吸収装置、即ちショツク・アブソーバ33を有効に働 かせる。

【0019】コントローラ基板17は、表面に種々の電 子素子を実装した多層式の印刷回路基板で構成されてお り、HDA11及び13の動作の制御を行ない、HDA への情報、またはHDAからの情報を結合し、そして、 ホスト・コンピユータ・システムにインターフエイスす 20 るために必要な電子回路を与える。また、制御基板17 は、基板の後縁側に装着された電力供給用コネクタ5 3、コントローラのインターフエイス用コネクタ55及 びジヤンパ・プロツク、即ち、付加的なコネクタ57を 含んでいる。ケーブル59は、HDA11及び13と、 HDAハウジング上に装着されているデータ・チヤネル 用基板61及び63とにコントローラ基板17を接続し ている。コントローラ基板17は、図7を参照して細述 する。

【0020】図3及び図4を参照すると、コントローラ 基板17が基台15の底部側に装着されていることが分 る。コントローラ基板17の前部にあるスロット(切り 込み) 45(図2)は、基台15の底部側に形成された 対応するスタツド、またはクリツア (図示せず) に係合 する。コントローラ基板17は、基板17の後縁部の位 置で係合する後部装着ブラケツト65(図1)によつて 定位置に保持され、ブラケツト65のタブ71とスロツ ト67とを通るボルト及びナットによつて基台15に固 定される。基台15は、下側に延びる側壁及び前壁73 及び75を含み、これらの壁部は、底板21が基台15 40 に装着された時に、コントローラ基板17の収納室を形 成する。前壁75は、コントローラ基板の電子素子のた めの冷却用空気路を与えるために、前壁を通過して形成 された空気流通口のパターンを含んでいる。

【0021】上部カバー19は、開孔81を通るボルト 及びナット83で固定されるスロット79によって基台 15に固定されている。下部カバー21は、基台の前壁 75の下部にあるスロツト(図示せず)と係合するタブ 85によつて基台15の底部側に装着され、そして、基 10

ト69によつて固着されている。完全に組立てられた 時、2つのHDA11及び13は、基台15の上の上部 収納室中に収納され、そして、コントローラ基板17 は、基台15の下部収納室中に収納される。上部カバー 19の前壁及び後壁87及び89は、HDA及び関連素 子の冷却を行なうために、それらの壁を貫通して形成さ れた通気孔のパターンを持つている。下部収納室の後部 は、下部収納室を通して冷却用の空気を流し、かつ、コ ントローラ基板のコネクタ53、55及び57を挿抜す るために解放されている。

【0022】図4に示されているように、組立てられた 複数デイスク・ドライブ・システムは、高さが約82. 5ミリメートル、幅が約146.0ミリメートル、長さ が約209.5ミリメートルである5.25インチ(1 33.35ミリメートル)デイスク・ドライブの持つ標 準形状特徴値を有する完成されたプラグ・イン式デイス ク・ドライブ装置90を形成する。これは、デイスク・ ドライブを6つの異なつた位置に装着できるように、こ の分野の標準の装着用開孔パターンが与えられる。コン トローラ基板のコネクタ53、55及び57は、この分 野の標準部品で構成されている。複数デイスク・ドライ ブ装置90は、他の5.25インチの標準形状特徴値を 持つデイスク・ドライブに対して完全な互換性を持ち、 そして、例えばPCのようなコンピユータ中の任意の 5. 25インチのスロツト、即ちラツクで用いることが できる。

【0023】上述した本発明の良好な実施例中で用いら れたHDA11及び13は、5.25インチのデイスク ・ドライブの形状特徴値の幅にほぼ等しい長さと、5. 25インチのデイスク・ドライブの形状特徴値の長さの ほぼ半分に等しい寸法の幅を持つており、これは、3. 5インチのデイスク・ドライブの形状特徴値の寸法とほ ば同じである。図5及び図6は、本発明の複数デイスク ・ドライブ・システム10に用いるのに適した3.5イ ンチの形状特徴値のデイスク・ドライブのためのHDA の平面図及び分解図である。

【0024】図5及び図6を参照すると、デイスク・ド ライブ100は、ハウジング101と、組み立てられた 後にブラケツト27 (図1を参照)の内側で基台15上 に装着されるハウジング・カバー103とを含んでい る。ハウジング101の内で回転自在に装着されている アクチユエータ・シヤフト117に対してアクチユエー タ・アーム組立体119が設けられている。アクチュエ ータ・アーム組立体119の一端には、複数個のアーム 123を持つ櫛状の構造体、即ちEプロツク121が設 けられている。Eブロツク121上の独立したアーム1 23には、加重用スプリング125が設けられている。 各加重用スプリングの端部には、磁気変換へツド(図示 せず)が取り付けられている。加重用スプリング125 台の後部のスロツト77及び67を通るボルト及びナツ 50 及びスライダ127が設けられているアクチユエータ・

アーム組立体119の反対側には、ボイス・コイル12 9がある。

【0025】ハウジング101の中には1対の磁石13 1が設けられている。1対の磁石131及びボイス・コ イル129は、アクチユエータ・シヤフト117の周り で回転させるために、アクチユエータ・アーム組立体1 19に回転力を与えるボイス・コイル・モータの主要要 素である。また、ハウジング101の中に回転軸133 が設けられている。回転軸133に対して複数枚のスト レージ・デイスク135が装着されている。回転軸用モ ータ (図示せず)は、選択された速度でデイスクを回転 させるために回転軸に連結されている。図6に示したよ うに、8枚のデイスク135が、相互に離隔した態様で 回転軸133に装着されている。それらが組立てられた 時、各加重スプリング125の端部にある磁気ヘッドが デイスクの1面に密着するように、独立した夫々のアー ム123はデイスク135の間に延びている。情報をス トアしたり、検索したりする(書込み/読取り)間で、 制御信号に応答するボイス・コイル・モータは、磁気へ ツドをデイスクの面上で移動させる。

【0026】図7を参照すると、2つのHDA11及び 13 (図1に示されたような)の下部収納室の中に、1 つの電子コントローラ基板、即ちカード17が装着され ており、このカードは2つのHDAにより共用される。 コントローラ基板の1つの例を説明する目的で、2つの HDA11及び13はドライブA及びドライブBと呼ば れる。各ドライブA及びBは、インターフエイス・プロ セツサと、サーボ制御プロセツサと、幾つかの論理モジ ユールと、デイジタル/アナログ・コンバータと、幾つ かのドライバ及びレシーバと、それらに関連する回路と によつて電子的に制御される。各ドライブA、B用の別 個のチャネル基板137 (図6参照) に装着されたデー タ・チヤネル回路を除いて、すべての制御回路及び電子 素子は、コントローラ基板17上に設けられている。効 率上及び部品を節約する目的で、幾つかの素子は、2つ のドライバA、Bによつて物理的に共用されるけれど も、コントローラ基板17は、ドライブAの制御を与え るための半分の部分A、149と、ドライブBの制御を 与えるための半分の部分B、151に論理的に分割され ている。

【0027】両方のドライバ用の制御電子素子は、動作 及び構造が共に実質的に同じだから、一方のドライバの 動作のみを以下に説明する。

【0028】各ドライブA、B用のサーボ・マイクロ・ プロセツサ (図示せず) は、閉ループのサーボ・システ ムを介して回転軸用モータの速度を制御し、回転軸の同 期機能を行なう。サーボ用マイクロ・プロセツサは、ラ イン141及び143上に夫々関連するドライブのため の回転軸用モータの制御信号を与える。回転軸は、コン 子直流モータ153によつて直接に駆動される。 停止信 号を受け取つた時には、回転軸を急速に停止するように ダイナミツク制御の制動が用いられている。

12

【0029】アクチユエータ155は、ボイス・コイル ・モータとは反対側に装着された読取り/書込み変換へ ツドを持つており、ボイス・コイル・モータによつて駆 動される揺動形式のアーム組立体である。サーボ用マイ クロプロセツサは、最初に、電源投入ステツブを管理 し、そして、アクチユエータのサーボ・システムを校正 する。デイスク面上において、変換ヘツドの位置付け及 び追跡の閉ループ制御を与えるすべてのアクチュエータ 制御信号は、サーボ用マイクロプロセツサによつて与え られる。使用されるデイスク面とヘツドとは、デイスク 上の所望のトラツク上に中心付けられる読取り/書込み ヘツドを維持するために、アクチユエータ・サーボへの フイードバツクを与える。サーボ用マイクロプロセツサ は、アクチユエータの位置を監視して、探索動作によつ て目標のトラツクを決定する。探索動作の間で使用され るサーボ・ヘツドは、サーボ動作に対してトラツク横断 情報を与える。その時の入力状態に応答して、サーボ用 マイクロプロセツサは、サーボ信号のゲート動作、校正 動作、トラツク追跡動作、エラー検出動作及び復旧動作 にアクセスするための制御信号を発生する。サーボ用マ イクロプロセツサは、ライン145及び147を通して 関連するアクチユエータ・サーボ回路にサーボ制御信号 を与える。

【0030】インターフエイス・マイクロプロセツサ (図示せず)は、ホスト・コンピユータと、それに関連 するドライブとの間のすべてのインターフエイス信号を 制御し、割り込む。インターフエイス・マイクロプロセ ツサは、関連するドライブに対して回転軸の始動及び停 止信号を発生する。書込み動作、検出動作、デコード動 作、エラー検出及びエラー訂正動作のためのコード化を 含むすべてのデータ処理回路及び論理回路は、ライン1 39A及び139Bを介してマイクロプロセツサに接続 されたドライブA、B夫々のための別個のデータ・チヤ ネル基板137 (図6参照)上に設けられている。イン ターフエイス・マイクロプロセツサは、関連するドライ ブA、Bとホスト・コンピユータ・システムとの間のデ 40 ータ転送と、デイスク媒体の読取り/書込みアクセス と、デイスクの故障検出及びエラー復旧管理とを制御す る。加えて、インターフエイス・マイクロプロセツサ は、診断動作を行ない、回転軸の状態の監視をする。 【0031】複数デイスク・ドライブ装置90は、コン トローラ基板17の後縁側に装着されたコネクタ53. 55及び57を介してホスト・コンピユータ・システム に接続される。コントローラ基板は、デイフアレンシャ ル・バージョンか、またはシングル・エンデッド・バー ジョンの何れかのANSIスタンダードで標準化された トローラ基板から電力を受け取るイン・ハブ形式の無刷 50 SCSI、またはIPIを用いることができる。良好な

[0032]

実施例において、シングル・エンデツド・バツフアード SCSIが用いられており、インターフエイス信号のコネクタ55は、ANSI/SCSIの仕様に適合した50ピンのコネクタである(良好な実施例ではモレツクス社の部品番号70246のコネクタが使用された)。下\* \*記の表1に各ピンの割り当てが示されている。DCパワー・コネクタ53は、+12ボルト及び+5ボルトの電力と、2つのシステムのグランドとをコントローラ基板17に与える4ピンのコネクタである。

14

信号名	導体ピン番号		信号名
グランド	1	2	-DB (0)
グランド	3	4	-DB (1)
グランド	5	6	-DB (2)
グランド・・・	7	8	-DB (3)
グランド	9	10	-DB (4)
グランド	11	12	-DB (5)
グランド	13	14	-DB (6)
グランド	15	16	-DB (7)
グランド	17	18	-DB (P)
グランド	19	20	グランド
グランド	21	22	グランド
オープン	23	24	オープン
オープン	25	26	TERMPUR
オープン	27	28	オープン
グランド	29	30	グランド
グランド	31	32	— ATN
グランド	33	34	グランド
グランド	35	36	-BSY
グランド	37	38	-ACK
グランド	39	40	-RST
グランド	41	42	— KSG
グランド	43	44	-SEL
グランド	45	46	-C/D
グランド	47	48	- REQ
グランド	49	50	- I/O

【0033】図8に示した動作プロック57は、26ピンのジヤンパ・ブロックを含んでいる。ピンA1乃至A6及びピンB1乃至B6は、関連するドライブA、BのSCSI装置のアドレス(SCSI ID)を選択してセットするのに用いられる。所望のアドレスは、1つ、または、それ以上のビット・ピンをグランドに短絡するジヤンパ手段、即ち短絡ブロック161を用いてセット※

※される。所望のドライブのアドレスのためのピンの構成は、表1に定義されている。ピンA9、A10及びB9、B10は、回転軸の同期を制御し、そして、残りのピンは、関連するA及びBドライブのための回転軸の始動及び停止電力を制御するのに用いられる。

ピツトロ	ピツト1	ピツト2	アドレス
オフ	オフ	オフ	0
オン	オフ	オフ	1
オフ	オン	オフ	2
オン	オン	オフ	3
オフ .	オフ	オン	4
オン	オフ	オン	5
オフ	オン	オン	6
オン	オン	オン	7

註: 上表において、「オフ」とは、ジャンパが取り付けられていないことを意味し、「オン」とはジャンパが取り付けられていることを意味する。

【0035】複数デイスク・ドライブ装置90は、5. 25インチのデイスク・ドライブが持つ形状特徴値の共 通コントローラ基板及び共通インターフエイス・コネク タを用いた2つのデイスク・ドライブのアレイを与えて いる。2つのデイスク・ドライブのアレイは、最適な性 能、つまりユーザが望む機能を与えるために、種々の構 20 成で制御することができる。良好な実施例の構成は、共 通のSCSIコネクタを介してアクセスされ、独立して アドレス可能な2つの別個のデイスク・ドライブを含ん でいる。各デイスク・ドライブA、Bのアドレス(SC SI ID) は、既に述べたようにジヤンパ・ブロック 57によつてセツトされる。 ユーザは、例えばドライブ Aだけを使用して、他のドライブを「緊急用(hot)」 の予備として維持することができる。他の案として、ド ライブA及びドライブBの両方を常用のデータ・ストレ ージ装置として使用することにより、単一の5.25イ 30 ンチの2つのデイスク・ドライブよりも大きなストレー ジ容量を与え、しかも、3.5インチのデイスク・ドラ イブに必要とされる電力及び冷却能力や、ケーブル、コ ネクタ等の数を減少することができる。

【0036】図9を参照すると、本発明を適用した複数デイスク・ドライブの第2の実施例が示されている。複数デイスク・ドライブ装置200は、基台201の上側に装着された4つのHDA203、205、207及び209を有する基台201と、4つのHDAの動作及び制御に必要とする回路及び電子素子を与える単一のコン40トローラ基板211とを含んでいる。HDA209、203、205及び207へ電力及び制御信号を与え、そして、これらのHDAからのデータ、または、これらのHDAへのデータを転送するためのコネクタの対213、215、217及び219が与えられている。電力供給用コネクタ221及びインターフエイス用コネクタ223は、ホスト・コンピユータ・システムに複数デイスク・ドライブ・システム200を接続するために、コントローラ基板211の後部側に装着されている。図1

\*は、HDAの下部にある基台201の下側に設けられている。同様に、図1に示した実施例と同様に、上部カバー227と底部カバーとは、上部収納室と、下部収納室とを形成するように基台201に固定され、上部収納室には4つのHDAを収容し、下部収納室にはコントローラ基板を収容している。組立てられた時、デイスク・ドライブ装置90の組立体は、共通のインターフエイス用コネクタを介して、別個にアドレス可能な4つの独立したデイスク・ドライブのアレイを形成する。

【0037】図9に示した本発明の実施例の複数デイスク・ドライブ装置200は、5.25インチのデイスク・ドライブの形状特徴値(図4に示したような)の全体の寸法にほぼ等しい寸法を持つている。基台201上に装着された4つのHDA203、205、207及び209の各々は、5.25インチのデイスク・ドライブの形状特徴値の長さの半分にほぼ等しい長さと、5.25インチのデイスク・ドライブの形状特徴値の幅の約半分にほぼ等しい幅とを持つている。

#### [0038]

【発明の効果】本発明は、コンピュータ業界で標準とされているデイスク・ドライブの形状特徴値に従つて組立てられた少なくとも2つのHDAを含む1つのデイスク・ドライブ組立体を与え、このデイスク・ドライブ組立体は、コンピュータ・システムの製造業者によつて与えられた形状特徴値と同じ形状特徴値の装着用スロット及びラックを持つコンピュータ・システムの形状特徴値のデイスク・ドライブと相互に交換可能である。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用し、標準の形状特徴値を採用した 複数デイスク・ドライブ・システムの第1の実施例を示 す斜視図である。

【図2】図1に示したデイスク・ドライブ・システムにおいて、基台上に装着されたデイスク・ドライブを説明するための斜視図である。

ントローラ基板211の後部側に装着されている。図1 【図3】図1に示したデイスク・ドライブ・システムをに関連して既に述べたように、コントローラ基板211×50 組立てた態様を示す斜視図である。

17

【図4】図3に示したデイスク・ドライブ・システムの 背面図であつて、コントローラ基板上のコネクタとカバ 一の冷却媒体の通路用開口を説明するための図である。

【図5】図1に示した複数デイスク・ドライブ・システ ムにおいて使用するのに好適なデイスク・ドライブの平 面図である。

【図6】図5に示したデイスク・ドライブを分解した斜 視図である。

【図7】図1に示したデイスク・ドライブ・システムの 制御及び相互通信を配分する電気回路の概念を説明する 10 59 ケーブル ためのブロツク図である。

【図8】図7に示したコントローラ基板のジャンパ・ブ ロツクを示す平面図である。

【図9】本発明の複数デイスク・ドライブ・システムの 第2の実施例を示す斜視図である。

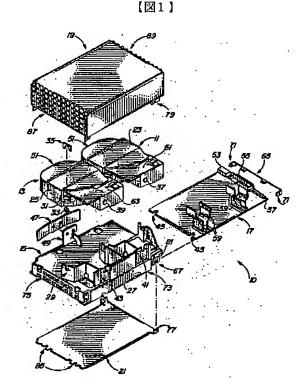
## 【符号の説明】

- 10 複数デイスク・ドライブ・システム
- 11、13 ヘツド及びデイスクの組立体 (HDA)
- 15 基台
- 17 コントローラ基板
- 19 上部カバー
- 21 下部カバー
- 23、25 HDAのハウジング
- 27 装着ブラケツト
- 31、37、39 スタツド

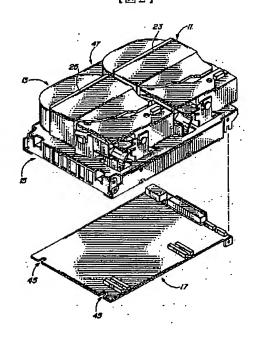
- 33 シヨツク・アブソーバ
  - 35 固定用クリツブ
- 41、43 スロツト板
- 45 コントローラ基板のスロット
- 47 振動減衰装置
- 49 ブラケツト
- 53 電力供給用コネクタ
- 55 インターフエイス・コネクタ
- 57 ジヤンパ・ブロック (付加的なコネクタ)

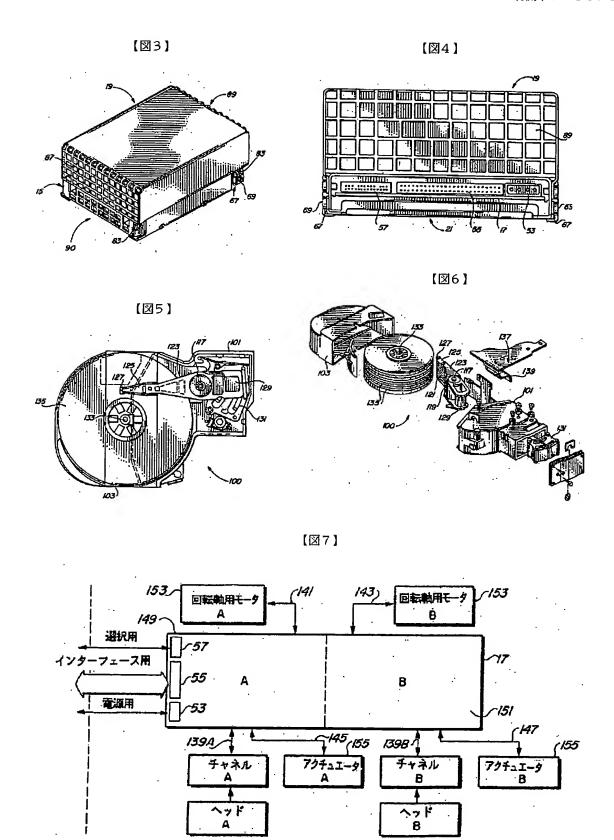
18

- - 61、63 データ・チヤネル基板
  - 65 後部装着ブラケツト
  - 73 基台の側壁
  - 75 基台の前壁
  - 87 上部カバーの前壁
  - 89 上部カバーの後壁
  - 90 複数デイスク・ドライブ装置
  - 100 デイスク・ドライブ
  - 101 デイスク・ドライブのハウジング
- 20 103 デイスク・ドライブのハウジング・カバー
  - 117 アクチユエータ・シヤフト
  - 119 アクチユエータ・アーム組立体
  - 133 回転軸
  - 135 ストレージ・デイスク



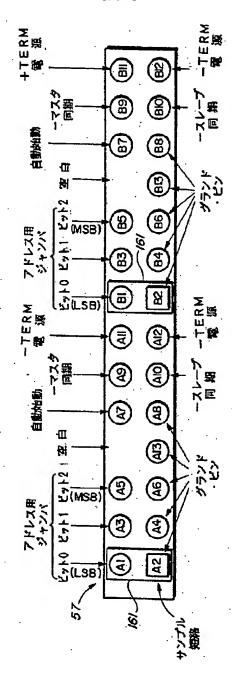
【図2】

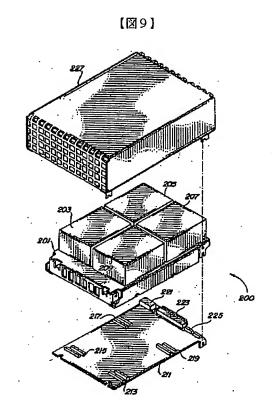




12/21/04, EAST Version: 2.0.1.4







### フロントページの続き

 (72)発明者 ジョン・スチュアート・ヒース アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンノ ゼ、タム・オシャンター・ドライブ 6608
(72)発明者 フーバート・チュー・リー アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンノ

ゼ、シェアウォーター・ドライブ 6872

(72)発明者 エウン・キョウング・ロー アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンノ ゼ、ノース・スター・サークル 1973(72)発明者 ロジャー・デール・スペンサー

アメリカ合衆国カリフォリニア州、サンノゼ、ハルストーン・レーン 974 (72)発明者 マイケル・リー・ワークマン

72) 発明者 マイケル・リー・ワークマン アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンノ ゼ、ウイスパーリング・パインス・ドライ ブ 6599